



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23819X

Issue Date: 20 Aug 2021

Title of Change:	Qualify mold compound EME-G770HM type D for XDFN devices assembled in ON Semiconductor Leshan facility.	
Proposed First Ship date:	20 Dec 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local onsemi Sales Office or Jim.Peng@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local onsemi Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Assembly Lot Number	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
onsemi Sites	External Foundry/Subcon Sites	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	None	
Description and Purpose:		
Upon the expiration of this PCN, these devices will be built with new mold compound at the same site. Datasheet specifications and product electrical performance remain unchanged. Reliability qualification and full electrical characterization over temperature will be performed.		
Material to be change	Before Change Description	After Change Description
Mold Compound	EME-G750N	EME-G750N EME-G770HM type D
There is no part number and product marking change as a result of this change.		



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23819X

Issue Date: 20 Aug 2021

Qualification Plan:

Qual Vehicle Device: NSVBAS21MX2WT5G

RMS: 77121

Package: X2DFN

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150°C,no bias	2016 hrs
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C	Before H3TRB, TC, UHASt, HAST, AC, IOL
HAST	JESD22 A110	130C/85%RH, 80% rated V or 100V max	192 hrs
TC	JESD22 A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
UHASt	JESD22 A118	Ta=130C, 85% RH, no bias	96 hrs
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25°C, delta Tj=100°C, On/off = 2 min	30000 cycs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-

Qual Vehicle Device: NST4617MX2T5G

RMS: 77677

Package: X2DFN

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150°C,no bias	2016 hrs
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C	Before H3TRB, TC, UHASt, HAST, AC, IOL
HAST	JESD22 A110	130C/85%RH, 80% rated V or 100V max	192 hrs
TC	JESD22 A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
UHASt	JESD22 A118	Ta=130C, 85% RH, no bias	96 hrs
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25°C, delta Tj=100°C, On/off = 2 min	30000 cycs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-

Qual Vehicle Device: SZNZ8F47VMX2WT5G

RMS: 76656

Package: X2DFN

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150°C,no bias	2016 hrs
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C	Before H3TRB, TC, UHASt, HAST, AC, IOL
HAST	JESD22 A110	130C/85%RH, 80% rated V or 100V max	192 hrs
TC	JESD22 A104	Ta= - 65°C to +150°C	1000 cyc
UHASt	JESD22 A118	Ta=130C, 85% RH, no bias	96 hrs
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25°C, delta Tj=100°C, On/off = 2 min	30000 cycs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23819X

Issue Date: 20 Aug 2021

Qual Vehicle Device: SNSR201MXT5G

RMS: 77684

Package: X2DFN

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V, 1008 Hrs	1008 hrs

Estimated date for qualification completion: 31 August 2021

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
ESD5581N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7241N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7410N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7462N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7551N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7571N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD8551N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESDM3033N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESDM3051N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
NSR201MXT5G	NSVBAS21MX2WT5G + SNSR201MXT5G
NSR0240MXWT5G	NSVBAS21MX2WT5G
ESDU3121MXT5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESDM3551N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

変更件名:	オン・セミコンダクターの樂山 (中国) 施設で組み立てられる XDFN 向けモールドコンパウンド EME-G770HM タイプ D を認定します。	
初回出荷予定日:	20 Dec 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Jim.Peng@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレサビリティ:	アセンブリ Lot Number (ロット番号)	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	なし	
説明および目的:		
本 PCN の期限切れに伴い、これらの機器は同拠点で新しいモールド・コンパウンドで製作されるようになります。データシートの仕様および製品の電気的性能に変更はありません。温度範囲全体にわたる信頼性認定と全面的な電気特性評価が実施される予定です。		
	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド	EME-G750N	EME-G750N EME-G770HM type D
今回の変更に伴う部品番号および製品マーキングの変更はありません。		

認定計画:

デバイス名: NSVBAS21MX2WT5G
 RMS: 77121
 パッケージ: X2DFN

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150° C,no bias	2016 hrs
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 ° C	Before H3TRB, TC, UHAST, HAST, AC, IOL
HAST	JESD22 A110	130C/85%RH, 80% rated V or 100V max	192 hrs
TC	JESD22 A104	Ta= - 65° C to +150° C	1000 cyc
UHAST	JESD22 A118	Ta=130C, 85% RH, no bias	96 hrs
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25° C, delta Tj=100° C, On/off = 2 min	30000 cycs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-

デバイス名: NST4617MX2T5G
 RMS: 77677
 パッケージ: X2DFN

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150° C,no bias	2016 hrs
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 ° C	Before H3TRB, TC, UHAST, HAST, AC, IOL
HAST	JESD22 A110	130C/85%RH, 80% rated V or 100V max	192 hrs
TC	JESD22 A104	Ta= - 65° C to +150° C	1000 cyc
UHAST	JESD22 A118	Ta=130C, 85% RH, no bias	96 hrs
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25° C, delta Tj=100° C, On/off = 2 min	30000 cycs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-

デバイス名: SZNZ8F47VMX2WT5G
 RMS: 76656
 パッケージ: X2DFN

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22- A103	Temp.=150° C,no bias	2016 hrs
PC	JESD22-A113	MSL 1 @ 260 ° C	Before H3TRB, TC, UHAST, HAST, AC, IOL
HAST	JESD22 A110	130C/85%RH, 80% rated V or 100V max	192 hrs
TC	JESD22 A104	Ta= - 65° C to +150° C	1000 cyc
UHAST	JESD22 A118	Ta=130C, 85% RH, no bias	96 hrs
IOL	MIL-STD-750	Ta=+25° C, delta Tj=100° C, On/off = 2 min	30000 cycs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-

デバイス名: SNSR201MXT5G

RMS: 77684

パッケージ: X2DFN

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj= max, V=100% rated V, 1008 Hrs	1008 hrs

認定完了予定日: 31 August 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
ESD5581N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7241N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7410N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7462N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7551N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD7571N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESD8551N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESDM3033N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESDM3051N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
NSR201MXT5G	NSVBAS21MX2WT5G + SNSR201MXT5G
NSR0240MXWT5G	NSVBAS21MX2WT5G
ESDU3121MXT5G	SZNZ8F47VMX2WT5G
ESDM3551N2T5G	SZNZ8F47VMX2WT5G